

M8 SOLDADURA EN PASTA NO CLEAN

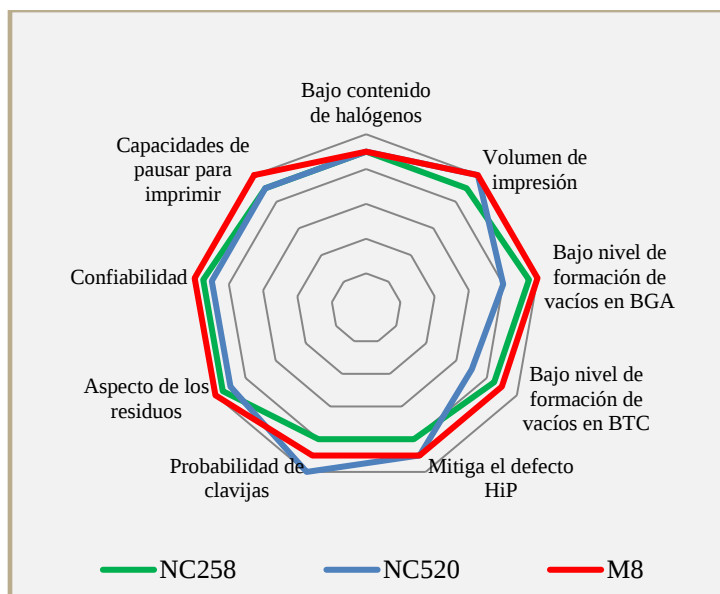
CARACTERÍSTICAS

- Bajo nivel de formación de vacíos (voids): <5% en BGA y <10% en BTC
- Excelentes eficiencias de transferencia de impresión <0.50 AR
- Elimina defectos HiP
- Cumple con REACH y RoHS*
- Formulada para uso con polvos T4, T5 y polvos más finos
- Potente mojado (wetting) en acabados de superficie sin plomo
- Residuo transparente mínimo. Cumple con requisitos LED
- Pasa prueba Bono y SIR para automotriz

DESCRIPCIÓN

M8 soldadura en pasta NC lleva el rendimiento al siguiente nivel. Desarrollada en combinación con T4, T5 y polvos más finos con y sin plomo, M8 proporciona eficiencias de transferencia estables requeridas para los dispositivos UFP y umBGA de hoy en día, reduciendo DPMO en las aplicaciones más complejas. Los activadores de M8 reducirán los defectos relacionados al mojado (wetting), como HiP (cabeza en almohada), y proporcionarán uniones brillosas y lisas. M8 ha reducido vacíos en BGA y BTC a valores tan bajos como <5% en BGA y <10% en los planos de tierra BTC. M8 pasa estrictos requisitos de prueba y electroquímica automotriz y de alta confiabilidad.

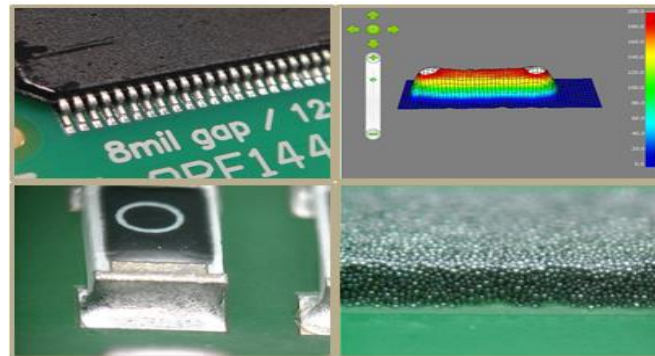
CARACTERÍSTICAS



*Aleaciones sin plomo.

*Toda la información es solo como referencia. No se debe utilizar como especificaciones de productos entrantes o para diseño de procesos. Consulte el Certificado de análisis para obtener información específica del producto.

CONDICIONES DE USO La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> para revisar términos y condiciones de AIM.



MANEJO Y ALMACENAMIENTO

PARÁMETRO	HORA	TEMPERATURA
Vida útil de pasta sellada y refrigerada	1 año*	0°C-12°C (32°F-55°F)
Vida útil de pasta sellada no refrigerada	3 meses*	< 25°C (< 77°F)

*Tamaño de polvo T4. Póngase en contacto con AIM para obtener información sobre la vida útil de T5.

No agregue pasta usada al contenedor de una pasta nueva. La pasta usada deberá ser almacenada por separado y la pasta nueva requiere un sellado hermético, ya sea con tapa interna o tapón. Una vez abierta, la vida útil de la soldadura en pasta dependerá de la aplicación y el entorno. Consulte la guía de manejo de pasta de AIM para más información. La aleación y las condiciones de almacenamiento pueden afectar la vida útil. Consulte el Certificado de Análisis de M8 para información específica del producto.

LIMPIEZA

Antes del reflujo: DJAW-10 de AIM elimina con eficacia la pasta para soldadura M8 de plantillas durante el proceso. Se puede aplicar DJAW-10 manualmente o usarse debajo del equipo de limpieza de la tablilla. DJAW-10 no secará la pasta M8 y mejorará las propiedades de transferencia. No aplicar DJAW-10 en exceso. No aplicar DJAW-10 a la parte superior de la tablilla. No se recomienda el uso de isopropanol (IPA) en el proceso, pero se puede usar como enjuague final de las tablillas.

Residuo de fundente después del reflujo: Los residuos de M8 pueden permanecer en el ensamble después del reflujo y no requieren limpieza. Para cuando sea obligatorio limpiar, AIM trabajó estrechamente con socios de la industria para asegurarse de que los residuos de M8 se puedan eliminar con eficacia con agentes removedores de fundente comunes. Comuníquese con AIM para obtener información sobre la compatibilidad de limpieza.

PERFIL DE REFLUJO

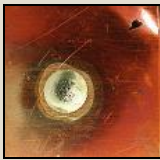
Se puede hallar información de perfil detallada en <http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements>. Comuníquese con AIM para obtener información adicional.

IMPRESIÓN

AJUSTES INICIALES RECOMENDADOS - DEPENDERÁN DEL DISEÑO DE LA PCB Y DEL PAD	
Parámetro	Configuración Inicial Recomendada
Presión de la Espátula	0.4 - 0.7kg/25mm
Velocidad de la Espátula	13 – 152 mm/second
Distancia de Desprendimiento	On Contact 0.00 mm
Distancia de Separación de la PCB	0.75 - 2.0 mm
Velocidad de Separación de la PCB	3 - 20 mm/second
Vida útil de la pasta de soldadura	>8 hours

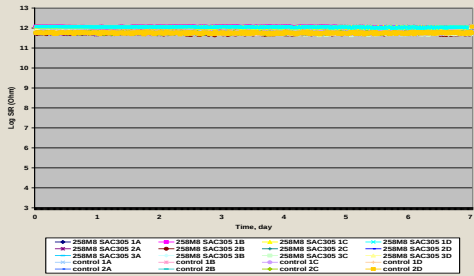
DATOS DE PRUEBAS

Nota: Todas las pruebas son para formulaciones T4 SAC305

NOMBRE	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADOS	
Clasificación IPC Flux	J-STD-004 A	ROL0	
Clasificación IPC Flux	J-STD-004 B y C	ROL1	
NOMBRE	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADOS	IMAGEN
Densidad de masa*		4.2 gr/cm ³ (*SAC305)	
Espejo de Cobre	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	BAJO	
Corrosión	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	PASA	Antes  Después 
Haluros cuantitativos	J-STD-004B 3.4.1.3 IPC-TM-650 2.3.28.1	Cl: 0.0% Típico	
Cualitativa Haluros, Cromato de Plata	J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	PASA	
Cualitativa Haluros, Fluoruro Punto	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	No fluoride	

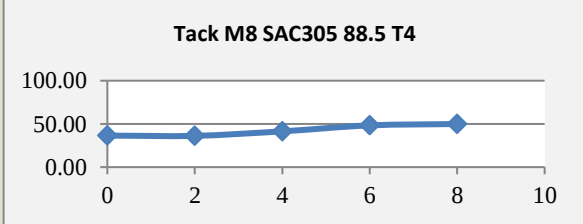
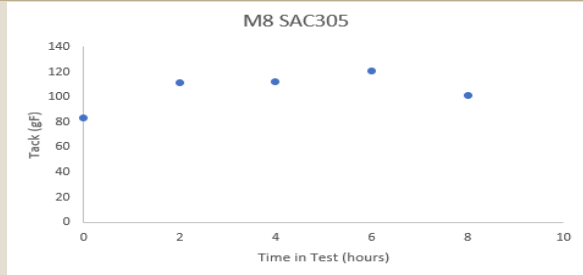
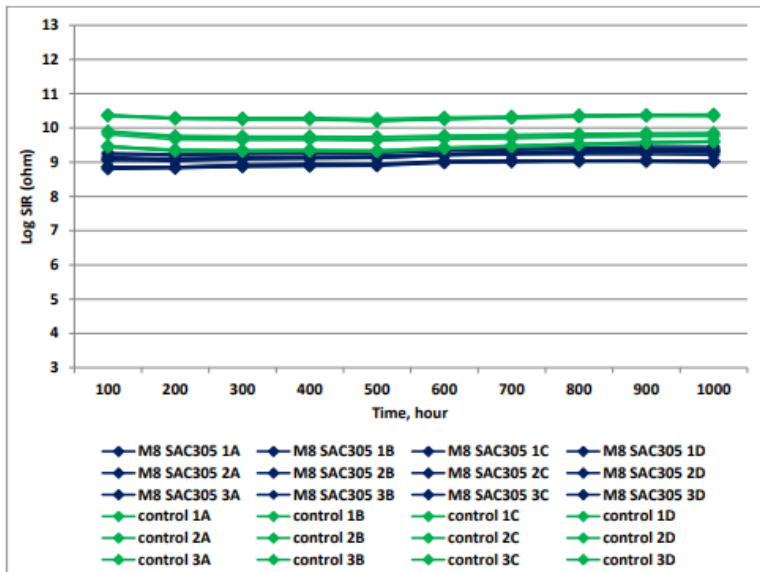
*Toda la información es solo como referencia. No se debe utilizar como especificaciones de productos entrantes o para diseño de procesos. Consulte el Certificado de análisis para obtener información específica del producto.

CONDICIONES DE USO La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> para revisar términos y condiciones de AIM.

NOMBRE	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADOS	IMAGEN
Resistencia Aislante de la Superficie	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	Todas las mediciones en los patrones de prueba exceden 100 MΩ	
Prueba Bono		PASA Fc<8.0 Típico	
Bomba de Oxígeno Pruebas de halógenos	EN14582:2007 SW 9056 SW 5050	Cl <122 mg/Kg	
Migración electroquímica	J-STD-004B 3.4.1.5 IPC-TM-650 2.6.14.1	PASA	
Residuos de Flux Sequedad	IPC-TM-650 2.4.47	PASA	Antes  Después 
Sólidos del flux, determinación de no volátiles	J-STD-004B 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	94.8% Típico	
Determinación del Valor Ácido	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	136 mgKOH/g flux Típico	
Viscosidad (Brookfield)	J-STD-005A 3.5.1 IPC-TM-650 2.4.34	400-1000 Kcps	
Viscosidad (Malcolm)	J-STD-005A 3.5.1 IPC-TM-650 2.4.34	70-300 Pa.S	
Visual	J-STD-004B 3.4.2.5	PASA	

*Toda la información es solo como referencia. No se debe utilizar como especificaciones de productos entrantes o para diseño de procesos. Consulte el Certificado de análisis para obtener información específica del producto.

CONDICIONES DE USO La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> para revisar términos y condiciones de AIM.

NOMBRE	MÉTODO DE PRUEBA	RESULTADOS	IMAGEN
Desprendimiento (Slump)	J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	PASA	
Prueba de dispersión	J-STD-004B 3.7.2 IPC-TM-650 2.4.46	PASA	
Bola de soldadura	J-STD-005A 3.7 IPC-TM-650 2.4.43	PASA	
Fuerza de Adhesión	J-STD-005A 3.8 IPC-TM-650 2.4.44	36.1 gf Time 0 Típico	
Fuerza de Adhesión	JIS Z 3284	105.92 gf Típico	
Migración de Iones	MS184-01, 4.3.5	PASA	

*Toda la información es solo como referencia. No se debe utilizar como especificaciones de productos entrantes o para diseño de procesos. Consulte el Certificado de análisis para obtener información específica del producto.

CONDICIONES DE USO La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> para revisar términos y condiciones de AIM.